19p-C8-17

極微細 Si MOSFET の準バリスティック輸送パラメータの抽出

Extraction of Quasi-Ballistic Transport Parameters in Ultrasmall Si MOSFETs

神戸大工¹, 阪大工², JST CREST³ 石田 良馬¹, 木場 隼介¹, 土屋 英昭^{1,3}, 鎌倉 良成^{2,3}, 森 伸也^{2,3}, 小川 真人¹

Kobe Univ.¹, Osaka Univ.², JST CREST³ [°]Ryoma Ishida¹, Shunsuke Koba¹, Hideaki Tsuchiya^{1,3}, Yoshinari Kamakura^{2,3}, Nobuya Mori^{2,3}, Matsuto Ogawa¹ E-mail: 137t204t@stu.kobe-u.ac.jp

最近、大橋氏らにより、音響フォノンの変位ポテンシャル(D_{ac})が Si/SiO₂ 界面で急激に上昇するというモ デル(vD_{ac} モデル)が提案され[1]、バルク MOS 反転層移動度のユニバーサル特性や SOI MOS 移動度 の実験結果の再現に成功している[1,2]。我々はこの vD_{ac} モデルをモンテカルロ(MC)・シミュレータに導 入し、超薄膜チャネル MOSFET のドレイン電流への影響を調べた所、チャネル膜厚が 6 nm 以下に薄層 化されると、D_{ac} を位置に依らず一定として取り扱う従来の cD_{ac} モデルではオン電流を高く見積もり過ぎる ことが明らかとなった[3]。このことはすなわち cD_{ac} モデルでは、極微細化された MOSFET で期待される準 バリスティック輸送特性を過大評価する可能性があることを表している。そこで本稿では vD_{ac} モデルを導 入した MC シミュレータを用いて、極短チャネル Si MOSFET の後方散乱係数と注入速度を解析し、準バ リスティック輸送パラメータに対する vD_{ac} の影響について検討を行った。

計算はダブルゲート(DG)構造 MOSFET に対して行い,音響フォノン,光学フォノン,イオン化不純物 及び界面ラフネスによる散乱を考慮した。MCシミュレータには vD_{ac} と従来の $cD_{ac}(D_{ac}$ の値は 13eV で一 定とした)の両者を音響フォノン散乱レートに取り入れて計算を行った。MCシミュレータにより得られた電 子移動度は、バルク MOS 反転層移動度のユニバーサル特性を再現し、また vD_{ac} の妥当性については SOI MOSFET の移動度の SOI 膜厚依存性の実験結果を、 cD_{ac} モデルよりも高い精度で記述できることで 確認している[3]。Fig. 1 にチャネル膜厚 T_{Si} =3 nm の DG MOSFET に対して得られた後方散乱係数 R の チャネル長依存性を示す。チャネル領域はアンドープとした。R の定義を含む準バリスティック輸送下での ボトルネック付近のキャリア輸送を Fig. 2 に模式的に描いた[4]。文献[4]の結果と同様に、チャネル長の縮 小とともに R が減少する傾向が得られたことから、短チャネル化とともにバリスティック輸送が顕在化するこ とが確認できる。 D_{ac} モデルの比較に関しては cD_{ac} の方が小さな R を示しており、予想通り cD_{ac} モデルで は準バリスティック輸送特性を過大評価する可能性があることが分かる。次に、注入速度 v_{inj} と後方チャネ ル速度 v_{back} のチャネル長依存性を Fig. 3 に示す。計算には vD_{ac} モデルを用いた。両者ともチャネル長に

殆ど依存しないが、vbackは vinjの約45~60%になっている ことから、vinj = vbackの近似[5]は正しくないことが再確認で きる。準バリスティック輸送パラメータの抽出には、後方散 乱を引き起こす主要散乱の一つである音響フォノン散乱 の取り扱いに注意を払う必要があると考えられる。

<u>文献</u>[1] T. Ohashi et al, *IEDM Tech. Dig.*, p. 390, 2011. [2] T. Ohashi et al, *SSDM* 2012, p. 807, 2012. [3]木場他,本応用物理学会で発表予定. [4] H. Tsuchiya et al., *IEEE-TED* 53 (2006) 2965. [5] M. Lundstrom, *IEEE-EDL* 18 (1997) 361.



Fig. 2. Schematic diagram of quasi-ballistic transport in a MOSFET [4].



Fig. 1. L_{ch} dependences of backscattering coefficient *R* calculated using vD_{ac} and cD_{ac} approaches. V_{G} =0.6V, V_{D} =0.5V, T_{ox} =0.5nm and T_{Si} =3nm.



Fig. 3. L_{ch} dependences of v_{inj} and v_{back} calculated using vD_{ac} approach.